

性能特点：

- 频率范围：DC-20GHz
- 插入损耗：1.7dB@20GHz
- 隔离度：42dB@20GHz
- 开态回波损耗：17dB
- 关态回波损耗：13dB
- 芯片尺寸：1.5mm×1.5mm×0.1mm

产品简介：

HH-SW20020 是一款匹配式单刀双掷开关芯片，该芯片在 DC-20GHz 频率范围可提供小于 1.7dB 的插入损耗以及大于 42dB 的隔离度。

电参数： (TA=25°C)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	DC-20			GHz
插入损耗	1.2	-	1.7	dB
隔离度	42	55	-	dB
回波损耗 (ON)	17	-	-	dB
回波损耗 (OFF)	13	-	-	dB
输入 P-1	-	18	-	dBm

使用限制参数： (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

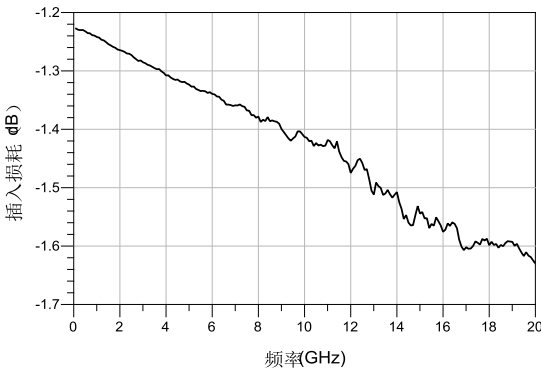
最大输入功率	30dBm
存储温度	-65°C-150°C
使用温度	-55°C-125°C

真值表：

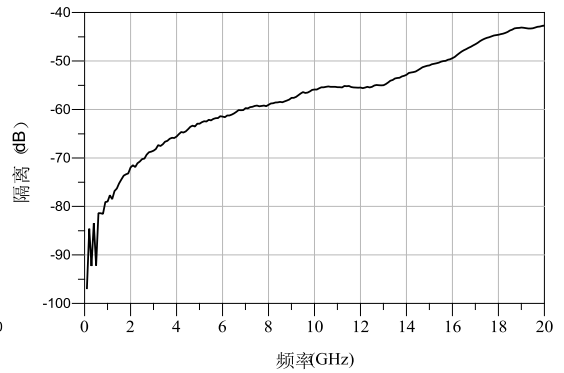
控制电压 (V)		通断状态	
1	2	IN-OUT1	IN-OUT2
0	-5	ON	OFF
-5	0	OFF	ON

典型曲线：

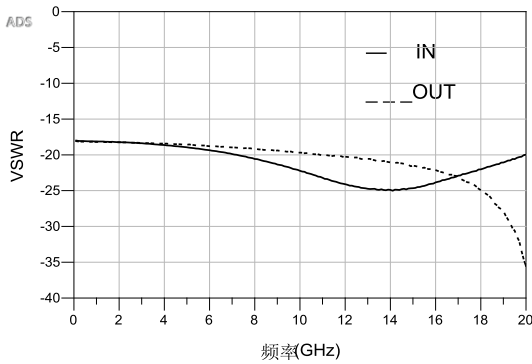
插入损耗



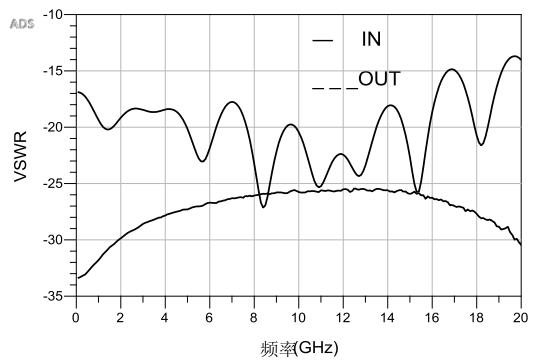
隔离度



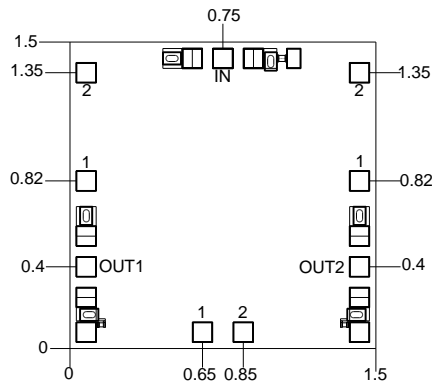
开态回波损耗



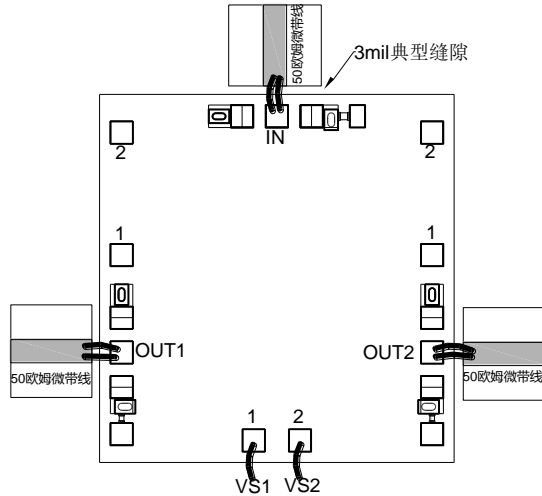
关态回波损耗



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

注意事项：输入输出无隔直电容

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。